

上海南芯半导体科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东的合法权益，公司发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司运营效率与市场竞争力，切实保护投资者合法权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

2026 年上半年，公司评估了 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度的执行情况，具体如下：

一、专注主营业务，提升经营质量

2026 年上半年，公司聚焦主营业务，持续加大研发投入，有序推进核心技术与产品创新。客户拓展方面，重点发力海外市场，深化全球客户合作；汽车电子领域着力提升市场份额，并积极布局工业领域、智能算力领域等新兴市场；供应链管理上，公司积极应对产能趋紧态势，加强保供能力，并持续强化成本管控，多措并举，全方位增强公司竞争韧性。

1、消费市场需求承压，公司实现营业收入小幅增长

2026 年以来，消费电子终端市场整体呈现需求承压、品类及价格均表现分化的特征。受存储器等核心零部件价格上涨并逐步向终端产品售价传导以及前期消费补贴对部分换机需求的提前释放、补贴支持力度边际减弱等因素影响，智能手机、个人电脑、平板电脑等传统消费电子产品出货量出现不同程度下降，其中中低端及价格敏感型产品承压相对更为明显。根据 IDC 数据，2026 年第一季度和第二季度，中国智能手机出货量分别同比下降 3.3%和 4.3%。根据 Omdia 数据，2026 年第一季度，中国大陆个人电脑和平板电脑出货量分别同比下降 2%和 5%；IDC 数据显示，同期中国消费平板出货量同比下降 5.6%。2026 年以来，与传统消费电子市场相对承压不同，AI 基础设施、汽车电动化智能化、工业自动化及机器人等领域仍保持较强发展动能。这些领域市场需求的增长不仅来自终端数量增加，还来自算力密度、自动化程度及单机芯片价值量提升。2026 年上半年，

我国高技术制造业增加值同比增长 13.3%，工业机器人和集成电路产量分别同比增长 28.0%和 23.1%，显著高于同期整体工业生产增速。

面对上述市场环境，2026 年上半年，公司充分发挥技术创新优势，持续加大研发投入，提升产品市场份额，积极拓展海外市场，在保持消费电子业务核心竞争优势的前提下不断加快丰富汽车、工业和智能算力领域的产品结构，加快新应用领域的营收增长。截至报告期末，公司实现营业收入 1,546,385,212.25 元，较去年同期实现 5.19%的增长。

2026 年下半年，公司将继续保持消费电子业务优势的同时加快汽车电子、工业和智能算力领域业务的拓展步伐。高端消费电子领域，公司将围绕 AI 手机、AI PC、AI 眼镜等新兴终端提供全链路电源解决方案，通过技术迭代与升级和推出新产品，持续稳定核心品牌客户份额。汽车电子领域，公司将在现有业务布局的基础上，加速向海内外主流整车厂和 Tier-1 厂商渗透，扩大现有大客户的份额，提高汽车业务的营收占比。同时，在智能算力领域和工业领域，公司将坚持大客户市场策略，基于公司在大电流 DC-DC、多相电源、高压电源管理等技术和产品，推动公司在智能算力领域、通信基站、储能管理、智能机器人、智能化设备等工业应用领域的大客户拓展。综上，2026 年公司将持续以大客户市场策略为核心，提高现有业务的市场份额，加速新兴应用领域业务的市场拓展，推进公司主营业务的稳健增长。

2、供应链产能趋紧，毛利率较去年同期下降

2026 年以来，半导体晶圆代工及封装测试环节呈现产能趋紧，供应价格上涨的态势。受 AI 服务器、数据中心及边缘 AI 应用快速发展影响，电源管理芯片、功率器件及高性能计算相关芯片需求增加，部分制造资源持续向 AI、高算力及高附加值产品倾斜；与此同时，原材料、贵金属、能源及人工等成本上升，进一步增加了晶圆制造和封装测试厂商的生产成本。根据 TrendForce 数据，全球前十大晶圆代工厂 8 英寸产线平均产能利用率已恢复至约 88%，预计 2026 年下半年进一步提高至约 90%。由于电源管理芯片和功率分立器件仍高度依赖 8 英寸制造平台，同时部分头部晶圆厂持续缩减或重新配置 8 英寸产能，2026 年第一季度至第二季度晶圆代工价格平均上涨约 5%-15%。在 12 英寸成熟制程领域，AI 相关功率器件、硅中介层、FPGA 等产品对 55 纳米及以上制程的晶圆需求增加，部分供给相对紧张的工艺节点在 2026 年第二季度至第三季度之间也已出现约 5%-10%的涨价迹象。

面对上述供应链环境，公司通过加强与核心晶圆代工及封测厂商的战略合作，提前备货，优化产能分配与排产计划，确保关键物料稳定供应的同时强化成本管控，基于上述措施的持续落地，报告期内公司综合毛利率为 35.28%，较去年同期小幅下降 1.69 个百分点。

3、加强汽车、智能算力领域和工业领域的研发投入，增厚研发成果

2026 年上半年，公司汽车电子芯片从以 PMIC 为核心的“供电”环节，向高边开关、eFuse、全桥电机驱动等“驱动与控制”类产品持续延伸，形成覆盖智能驾驶、车身控制、智能座舱三大核心场景的全国产、一站式解决方案。在智能算力领域，公司构建了前端以 PFC+LLC Combo 控制器与 LLC SR 完成 AC-DC 转换，后端以自研 DrMOS 与多相控制器为 CPU/GPU 提供大电流核心供电的完整供电链路解决方案，覆盖从数据中心、边缘服务器到自动驾驶的广泛计算场景。在工业领域，公司重点加强传感芯片、大电流电源芯片等产品的研发，以覆盖机器人、能源等领域的应用需求。

截至 2026 年 6 月末，公司研发人员数量增至 885 人，较 2025 年上半年增长 17.06%，研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.50%。报告期内，公司研发投入 374,886,641.48 元，较上年同期增长 32.73%。报告期末，公司获得新增授权发明专利 36 项，累计获取专利 235 项。公司新增 8 项核心技术，均为自主研发，分别是高效率音频 Class-D 技术、OIS/AF 动态调压技术、用于 buck boost charger 的 OOA 控制技术、48V 升降压 DC-DC 技术、车规级 SBC 技术、全桥电机驱动技术、自适应动态分区驱动控制技术和高速高精度快速调压技术。

2026 年下半年，公司将持续深化技术积累，持续加大研发投入满足公司日益增长的产品需求，并积极拓宽引才渠道，高效整合研发资源，不断优化人才梯队，为公司的持续增长与长远发展筑牢根基。

4、汽车电子、工业应用及智能算力领域新产品成果显著

2026 年上半年，公司加快汽车电子、工业应用及智能算力领域的业务拓展，技术创新与市场拓展双轮并进，产品矩阵在广度与深度上实现同步跃升。

在汽车电子领域，公司发布了车规级全桥电机驱动芯片 SC77870XQ 系列（支持 12A 大电流、低导通电阻与全面诊断，适用于车身控制与热管理系统）以及 48V 汽车系统高性能双向 DC-DC SC8708Q/SC8709Q（最高 80V 耐压、多种模式无缝切换，通过 AEC-Q100 认证，助力 48V 架构从混动向纯电升级）等多款车规产品，持续推动智能驾驶、域控制器与智能座舱的国产化进程。

在工业应用及智能算力领域，公司推出大电流 POL 电源 SC812C0（支持单芯片 30A、最高 240A 并联输出，具备优异瞬态响应与 PMBus 实时监测能力）、全系列集成式电流传感器 SCS81XX 及线性霍尔效应电流传感器 SCS910X（闭环架构与自研 Hall 工艺结合，极致温漂控制及高带宽响应，覆盖中小至大量程电流检测）、多相 DrMOS 电源方案 SD13050+SD22442（60A 大电流 DrMOS 搭配四相数字控制器，支持 DCM 与 APS 功能及工业/车规版本，专为 CPU/GPU/SOC 算力芯片供电）等高性能电源产品，有力支撑 AI 算力、数据中心、储能、新能源汽车及工业自动化等高增长赛道。

2026 年下半年，公司将深化战略产品布局，加强公司在智能算力领域的电源管理芯片、车载应用的传感、通信、驱动、控制等芯片以及工业应用的传感及控制芯片，加速公司在新领域的业务进展，保持公司长期竞争力。同时，公司将不断加强技术创新，围绕产品核心 IP 和工艺，加强自主研发，打造技术护城河，保障产品的独特性和竞争力，提升产品性能。

5、加强资本运作，加快公司多元化业务战略发展

报告期内，经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2026〕1150 号文《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》予以注册，公司于 2026 年 6 月 18 日向不特定对象发行了 15,868,810 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 158,688.10 万元。经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕148 号）同意，公司本次发行的 158,688.10 万元可转换公司债券于 2026 年 7 月 10 日起在上交所挂牌交易。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用于公司智能算力领域电源管理芯片研发及产业化、车载芯片研发及产业化和工业应用的传感及控制芯片研发及产业化。通过本次向不特定对象发行可转债公司债券，公司加强了资金储备，为智能算力、汽车和工业领域的业务拓展提供了准备，有利于加快公司业务多元化发展。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

报告期内，公司坚持严格执行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《上海南芯半导体科技股份有限公司公司章程》《上海南芯半导体科技股份有

限公司募集资金管理制度》的规定，开设专户存储，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

公司稳步推进各项重点项目，其中“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”及“汽车电子芯片研发和产业化项目”均按计划结项。

“芯片测试产业园建设项目”计划使用 IPO 募集资金投入 5.70 亿元，截至 2026 年 6 月末，已经投入 1.49 亿元，项目投入进度达到 26.21%。该项目通过购置土地自建芯片测试厂房并投入相关测试设备（包括 FT 测试、CP 测试、烧录测试设备等）以支持公司研发的消费、车规和工业类芯片的生产测试需求，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提升公司产品质量管理水平。

2026 年，公司将围绕自身产品布局，积极推进芯片测试产业园的土建工程和厂房建设，加速对芯片产品测试自有能力的建设，加速该项目募集资金的投入，以实现公司往消费、汽车、工业多领域平台型发展战略，提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模提升。

三、持续完善公司治理，筑牢高质量发展根基

公司高度重视治理水平的提升，2026 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的相关要求，持续推进公众公司的规范运作，进一步完善和优化公司各项治理和管理制度，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基。

1、持续优化公司各项治理制度。公司积极响应证监会 2026 年施行的《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等各项监管规则的要求，修订《公司章程》及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等部分治理制度，通过进一步完善各项治理相关制度，着力构建运作规范、决策科学的法人治理架构。

2、推进环境、社会及公司治理（ESG）体系建设，将 ESG 理念深度融入公司战略规划、经营决策与日常运营，建立 ESG 治理架构与管理机制。积极践行绿色发展理念，强化节能环保、低碳运营与资源高效利用，推动绿色低碳转型；

切实履行社会责任，坚守商业道德，保障员工合法权益，积极投身社会公益、乡村振兴等事业，构建和谐共赢的利益相关方关系。

3、持续深化董事及高级管理人员证券法律法规专题培训，建立常态化、系统化学习机制。定期组织董事及高级管理人员认真学习证监会、交易所最新发布的监管规则、指引及规范性文件，积极参与监管机构、自律组织开展的各类合规培训与专题教育，持续强化资本市场法律法规、公司治理、信息披露等专业知识与合规理念，不断提升董事及高管人员的履职能力、规范运作意识与风险防范水平，为公司持续健康、高质量发展提供坚实保障。

四、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道

自上市以来，公司始终高度重视投资者关系管理工作，持续构建多元化的投资者沟通平台，通过投资者热线、上证 e 互动、公司官网投资者关系专栏、业绩说明会及股东大会等多种形式，增进投资者对公司经营发展情况的认知，与投资者保持高效良性互动。公司切实维护投资者的知情权，清晰传递公司价值理念与发展逻辑，为股东决策提供真实、准确、完整的信息支撑。

2026 年上半年，公司持续深化与投资者的沟通互动，积极建立高效顺畅的资本市场沟通机制，着力构建规范、透明、良性的投资者关系管理体系，不断优化沟通路径、丰富交流形式。通过“上证路演中心”“进门财经”等平台开展 2 次投资者线上交流活动，组织接待投资者实地调研不低于 12 次；同时依托投资者热线、e 互动平台、电子邮箱、策略交流会等多元渠道，提升沟通频次与响应效率，积极回应股东合理诉求与市场关注焦点，打通信息传递障碍，帮助投资者更深入、清晰、全面地认知公司内在价值，进一步提升投资者认同感与信心。

公司将持续健全投资者意见征集与反馈闭环机制，强化信息披露透明度，精准把握投资者核心诉求并开展针对性回应。在严守合规底线的前提下，确保投资者全面、及时掌握公司经营动态与发展战略，持续深化双向沟通，不断夯实投资者信任基础，凝聚长期发展共识。

五、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终将投资者利益置于优先地位，以持续、稳定的现金分红切实保障全体股东权益。结合公司盈利水平、现金流状况及未来发展规划，科学制定合理的利润分配方案。

2026 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十七次会议，2026 年 5 月 20 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司以权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至权益分派股权登记日，公司总股本为 427,663,170 股，扣除回购专户股数 1,752,889 股后剩余可参与本次利润分配的股份数为 425,910,281 股，共计派发现金红利总额为 106,477,570.25 元（含税）。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，将密切关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

六、强化管理层与股东的利益共担共享

2026 年 4 月 14 日，公司股东会审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2026 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对公司核心员工共计 373 名激励对象授予 286.1467 万股限制性股票。

2026 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，对公司核心员工共计 35 名激励对象授予 63.8533 万股限制性股票。

公司对激励计划设定了公司层面营收收入的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

此外，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基础薪资、津贴及绩效奖金组成。公司依据经营业绩及盈利状况，结合个人绩效目标完成情况进行评估，确定高管的绩效奖金。绩效奖金与公司及个人绩

效挂钩。公司绩效指标包括销售额、毛利润、净利润、产品开发、客户拓展情况、投产计划、生产质量、研发项目、组织人才等，对公司经营进行全面评估。个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。2026 年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

七、其他事宜

公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的相关措施进行审慎评估，并按规定及时履行信息披露职责。未来，公司将始终聚焦主营业务，持续提升经营管理水平与运营效能，以稳健的经营业绩与规范的公司治理，切实履行上市公司应尽职责，回馈投资者的信任与支持。同时，公司将继续维护良好的市场形象，助力资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日